



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120615000A

2012 年 10 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA/PWR/HVAL 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更のご案内

(既報 720 製品からの対象除外 12 製品の連絡)

(初版 PCN20120615000 2012 年 6 月 28 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたとものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	下記変更について既報 720 製品からの対象除外 12 製品の連絡になります。 HPA/PWR/HVAL 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	12 月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更について既報 720 製品からの対象除外 12 製品の連絡になります。
 1. 3um Cu(銅)線変更対象製品の一部を対象から除外しました。下記を参照下さい。
 弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント)/HVAL(ハイボリュームアナログ
 ロジック) 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイアを使用して製造していますが、機
 械/電氣的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、
 Cu(銅)線ボンディングワイアに変更します。ボンディングワイア以外の部材及び組立サイトの変更
 はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性
 への影響はありません。

変更内容
ボンディングワイア

現行
Au(金)線

変更後
Cu(銅)線

	現行	変更後
ボンディングワイア (径, 部材)	1.0/1.2 Mil, Au	1.0/1.3 Mil, Cu

理由: 機械/電氣的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名 1.0 mils 径 Cu(銅)線				
ADS1112IDGSR	INA330AIDGST	OPA2743EA/2K5G4	TLV5606CDGK	TPS62008DGS
ADS1112IDGSRG4	INA330AIDGSTG4	OPA2822E/250	TLV5606CDGKG4	TPS62008DGSR
ADS1112IDGST	INA332AIDGKR	OPA2822E/250G4	TLV5606CDGKR	TPS62008DGSRG4
ADS1112IDGSTG4	INA332AIDGKRG4	OPA2822E/2K5	TLV5606CDGKRG4	TPS62050DGS
ADS1244IDGSR	INA332AIDGKT	OPA2822E/2K5G4	TLV5606IDGK	TPS62050DGS
ADS1244IDGSRG4	INA332AIDGKTG4	OPA2830IDGKR	TLV5606IDGKG4	TPS62050DGSR
ADS1244IDGST	INA333AIDGKR	OPA2830IDGKRG4	TLV5606IDGKR	TPS62050DGSRG4
ADS1244IDGSTG4	INA333AIDGKRG4	OPA2830IDGKT	TLV5606IDGKRG4	TPS92001DGK
ADS1245IDGST	INA333AIDGKT	OPA2830IDGKTG4	TLV5616CDGK	TPS92001DGKR
ADS1245IDGSTG4	INA333AIDGKTG4	OPA2832IDGKR	TLV5616CDGKG4	TPS92002DGK
ADS7822EB-1/2K5	INA337AIDGKR	OPA2832IDGKRG4	TLV5616IDGK	TPS92002DGKR
ADS7822EB-1/2K5G4	INA337AIDGKRG4	OPA2832IDGKT	TLV5616IDGKG4	UCC25705DGK
BQ2057CDGK	INA337AIDGKT	OPA2832IDGKTG4	TLV5616IDGKR	UCC25705DGKG4
BQ2057CDGKG4	INA337AIDGKTG4	OPA2835IDGS	TLV5616IDGKRG4	UCC25705DGKTR
BQ2057CDGKR	INA338AIDGST	OPA2835IDGSR	TLV5623CDGK	UCC25705DGKTRG4
BQ2057CDGKRG4	INA338AIDGSTG4	OPA2836IDGS	TLV5623CDGKG4	UCC25706DGK
BQ2057DGK	LM258ADGKR	OPA2836IDGSR	TLV5623CDGKR	UCC25706DGKG4
BQ2057DGKG4	LM258ADGKRG4	OPA2889IDGSR	TLV5623CDGKRG4	UCC27321DGN
BQ2057PDGK	LM258DGKR	OPA2889IDGSRG4	TLV5623IDGK	UCC27321DGN
BQ2057PDGKG4	LM258DGKRG4	OPA2889IDGST	TLV5623IDGKG4	UCC27321DGNR
BUF04701AIDGSR	LM2903DGKR	OPA2889IDGSTG4	TLV5623IDGKR	UCC27321DGNRG4
BUF04701AIDGSRG4	LM2903DGKRG4	OPA2890IDGSR	TLV5623IDGKRG4	UCC27322DGN
DAC5574IDGS	LM2904DGKR	OPA2890IDGSRG4	TLV5624CDGK	UCC27322DGN
DAC5574IDGSG4	LM2904DGKRG4	OPA2890IDGST	TLV5624CDGKG4	UCC27322DGNR
DAC5574IDGSR	LM293ADGKR	OPA2890IDGSTG4	TLV5624CDGKR	UCC27322DGNRG4
DAC5574IDGSRG4	LM293ADGKRG4	OPA337EA/250	TLV5624CDGKRG4	UCC27425DGN
DAC6574IDGS	LM293DGKR	OPA337EA/250G4	TLV5624IDGK	UCC27425DGN
DAC6574IDGSG4	LM293DGKRG4	OPA337EA/2K5	TLV5624IDGKG4	UCC27425DGNR
DAC6574IDGSR	LM358ADGKR	OPA337EA/2K5G4	TLV5624IDGKR	UCC27425DGNRG4
DAC6574IDGSRG4	LM358ADGKRG4	OPA350EA/250	TLV5624IDGKRG4	UCC2809P-1
DAC7512E/250	LM358DGKR	OPA350EA/250G4	TLV5636CDGK	UCC2809P-1G4
DAC7512E/250G4	LM358DGKRG4	OPA350EA/2K5	TLV5636CDGKG4	UCC2809P-2
DAC7512E/2K5	LM393ADGKR	OPA350EA/2K5G4	TLV5636CDGKR	UCC2809P-2G4
DAC7512E/2K5G4	LM393ADGKRG4	OPA380AIDGKR	TLV5636CDGKRG4	UCC2809PTR-1
DAC7513E/250	LM393DGKR	OPA380AIDGKRG4	TLV5636IDGK	UCC2809PTR-1G4
DAC7513E/250G4	LM393DGKRG4	OPA380AIDGKT	TLV5636IDGKG4	UCC2809PTR-2
DAC7513E/2K5	OPA2300AIDGSR	OPA380AIDGKTG4	TLV5636IDGKR	UCC2809PTR-2G4
DAC7513E/2K5G4	OPA2300AIDGSRG4	OPA381AIDGKR	TLV5636IDGKRG4	UCC28C40DGK
DAC7574IDGS	OPA2300AIDGST	OPA381AIDGKRG4	TMP141AIDGKR	UCC28C40DGKG4
DAC7574IDGSG4	OPA2300AIDGSTG4	OPA381AIDGKT	TMP141AIDGKRG4	UCC28C40DGKR
DAC7574IDGSR	OPA2301AIDGKR	OPA381AIDGKTG4	TMP141AIDGKT	UCC28C40DGKRG4
DAC7574IDGSRG4	OPA2301AIDGKRG4	OPA615IDGSR	TMP141AIDGKTG4	UCC28C41DGK
DAC7811IDGS	OPA2301AIDGKT	OPA615IDGSRG4	TMP275AIDGKR	UCC28C41DGKG4
DAC7811IDGSG4	OPA2301AIDGKTG4	OPA615IDGST	TMP275AIDGKRG4	UCC28C41DGKR
DAC7811IDGSR	OPA2330AIDGKR	OPA615IDGSTG4	TMP275AIDGKT	UCC28C41DGKRG4
DAC7811IDGSRG4	OPA2330AIDGKRG4	OPA695IDGKR	TMP275AIDGKTG4	UCC28C42DGK
DAC7811IDGST	OPA2330AIDGKT	OPA695IDGKT	TMP411ADGKR	UCC28C42DGKG4
DAC7811IDGSTG4	OPA2330AIDGKTG4	OPA726AIDGKT	TMP411ADGKRG4	UCC28C42DGKR
DAC8501E/250	OPA2333AIDGKR	OPA726AIDGKTG4	TMP411ADGKT	UCC28C42DGKRG4
DAC8501E/250G4	OPA2333AIDGKRG4	OPA728AIDGKT	TMP411ADGKTG4	UCC28C43DGK
DAC8501E/2K5	OPA2333AIDGKT	OPA728AIDGKTG4	TMP411BDGKR	UCC28C43DGKG4
DAC8501E/2K5G4	OPA2333AIDGKTG4	PGA308AIDGSR	TMP411BDGKRG4	UCC28C43DGKR
DAC8531E/250	OPA2334AIDGSR	PGA308AIDGSRG4	TMP411BDGKT	UCC28C43DGKRG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

DAC8531E/250G4	OPA2334AIDGSRG4	PGA308AIDGST	TMP411BDGKTG4	UCC28C44DGK
DAC8531E/2K5	OPA2334AIDGST	PGA308AIDGSTG4	TMP411CDGKR	UCC28C44DGKG4
DAC8531E/2K5G4	OPA2334AIDGSTG4	RC4558DGKR	TMP411CDGKRG4	UCC28C44DGKR
DAC8532IDGK	OPA2335AIDGKR	RC4558DGKRG4	TMP411CDGKT	UCC28C44DGKRG4
DAC8532IDGKG4	OPA2335AIDGKRG4	RC4558IDGKR	TMP411CDGKTG4	UCC28C45DGK
DAC8532IDGKR	OPA2335AIDGKT	RC4558IDGKRG4	TMP75AIDGKR	UCC28C45DGKG4
DAC8532IDGKRG4	OPA2335AIDGKTG4	SN100103ODGK	TMP75AIDGKRG4	UCC28C45DGKR
DAC8571IDGK	OPA2340EA/250	SN100103ODGKR	TMP75AIDGKT	UCC28C45DGKRG4
DAC8571IDGKG4	OPA2340EA/250G4	SN200609046DGSR	TMP75AIDGKTG4	UCC29002DGK
DAC8571IDGKR	OPA2340EA/2K5	SN200609046DGSRG4	TPS2390DGK	UCC29002DGKG4
DAC8571IDGKRG4	OPA2340EA/2K5G4	SN200612054DGSR	TPS2390DGKG4	UCC29002DGKR
HPA00069AIDGKR	OPA2341DGS/250	SN200612054DGSRG4	TPS2390DGKR	UCC29002DGKRG4
HPA00224AIDGKR	OPA2341DGS/250G4	SN200703017DGSR	TPS2390DGKRG4	UCC35705DGK
HPA00244DGSR	OPA2342EA/250	SN200703017DGSRG4	TPS2391DGK	UCC35705DGKG4
HPA00314DGSR	OPA2342EA/250G4	THS4081CDGN	TPS2391DGKG4	UCC35706DGK
HPA00814IDGKR	OPA2342EA/2K5	THS4081CDGNG4	TPS2391DGKR	UCC35706DGKG4
INA156EA/250	OPA2342EA/2K5G4	THS4081CDGNR	TPS2391DGKRG4	UCC37321DGN
INA156EA/250G4	OPA2343EA/250	THS4081CDGNRG4	TPS2398DGK	UCC37321DGN4
INA156EA/2K5	OPA2343EA/250G4	THS4081IDGN	TPS2398DGKG4	UCC37321DGNR
INA156EA/2K5G4	OPA2343EA/2K5	THS4081IDGNG4	TPS2398DGKR	UCC37321DGNRG4
INA159AIDGKR	OPA2343EA/2K5G4	THS4081IDGNR	TPS2398DGKRG4	UCC37322DGN
INA159AIDGKRG4	OPA2344EA/250	THS4081IDGNRG4	TPS2399DGK	UCC37322DGN4
INA159AIDGKT	OPA2344EA/250G4	THS4521IDGKR	TPS2399DGKG4	UCC37322DGNR
INA159AIDGKTG4	OPA2344EA/2K5	THS4521IDGKT	TPS2399DGKR	UCC37322DGNRG4
INA200AIDGKR	OPA2344EA/2K5G4	THS4531IDGK	TPS2399DGKRG4	UCC3809P-1
INA200AIDGKRG4	OPA2345EA/250	THS4531IDGKR	TPS2491DGS	UCC3809P-1G4
INA200AIDGKT	OPA2345EA/250G4	TLC2551CDGK	TPS2491DGS4	UCC3809P-2
INA200AIDGKTG4	OPA2350EA/250	TLC2551CDGKG4	TPS2491DGSR	UCC3809P-2G4
INA201AIDGKR	OPA2350EA/250G4	TLC2551CDGKR	TPS2491DGSRG4	UCC3809PTR-1
INA201AIDGKRG4	OPA2350EA/2K5	TLC2551CDGKRG4	TPS3307-33DGN	UCC3809PTR-1G4
INA201AIDGKT	OPA2350EA/2K5G4	TLC2551IDGK	TPS3307-33DGN4	UCC3809PTR-2
INA201AIDGKTG4	OPA2353EA/250	TLC2551IDGKG4	TPS3307-33DGNR	UCC3809PTR-2G4
INA202AIDGKR	OPA2353EA/250G4	TLC2552CDGK	TPS3307-33DGNRG4	UCC38C40DGK
INA202AIDGKRG4	OPA2353EA/2K5	TLC2552CDGKG4	TPS40211DGQ	UCC38C40DGKG4
INA202AIDGKT	OPA2353EA/2K5G4	TLC2552IDGK	TPS40211DGQG4	UCC38C40DGKR
INA202AIDGKTG4	OPA2355DGS/250	TLC2552IDGKG4	TPS40211DGQR	UCC38C40DGKRG4
INA203AIDGSR	OPA2355DGS/250G4	TLC2555IDGK	TPS40211DGQR4	UCC38C41DGK
INA203AIDGSRG4	OPA2373AIDGSR	TLC2555IDGKG4	TPS61013DGS	UCC38C41DGKG4
INA203AIDGST	OPA2373AIDGSRG4	TLC3541IDGK	TPS61013DGS4	UCC38C42DGK
INA203AIDGSTG4	OPA2373AIDGST	TLC3541IDGKG4	TPS61014DGS	UCC38C42DGKG4
INA204AIDGSR	OPA2373AIDGSTG4	TLC3541IDGKR	TPS61014DGS4	UCC38C42DGKR
INA204AIDGSRG4	OPA2380AIDGKR	TLC3541IDGKRG4	TPS61014DGSR	UCC38C42DGKRG4
INA204AIDGST	OPA2380AIDGKRG4	TLC3545IDGK	TPS61014DGSRG4	UCC38C43DGK
INA204AIDGSTG4	OPA2380AIDGKT	TLC3545IDGKG4	TPS61015DGS	UCC38C43DGKG4
INA205AIDGSR	OPA2380AIDGKTG4	TLC4541IDGK	TPS61015DGS4	UCC38C43DGKR
INA205AIDGSRG4	OPA2381AIDGKR	TLC4541IDGKG4	TPS61015DGSR	UCC38C43DGKRG4
INA205AIDGST	OPA2381AIDGKRG4	TLC4541IDGKR	TPS61015DGSRG4	UCC38C44DGK
INA205AIDGSTG4	OPA2381AIDGKT	TLC4541IDGKRG4	TPS61016DGS	UCC38C44DGKG4
INA206AIDGSR	OPA2381AIDGKTG4	TLC4545IDGK	TPS61016DGS4	UCC38C44DGKR
INA206AIDGSRG4	OPA2683IDGSR	TLC4545IDGKG4	TPS61016DGSR	UCC38C44DGKR/1
INA206AIDGST	OPA2683IDGSRG4	TLC5615CDGK	TPS61016DGSRG4	UCC38C44DGKRG4
INA206AIDGSTG4	OPA2683IDGST	TLC5615CDGKG4	TPS62000DGS	UCC38C45DGK
INA207AIDGSR	OPA2683IDGSTG4	TLC5615CDGKR	TPS62000DGS4	UCC38C45DGKG4
INA207AIDGSRG4	OPA2703EA/250	TLC5615CDGKRG4	TPS62001DGS	UCC38C45DGKR
INA207AIDGST	OPA2703EA/250G4	TLC5615IDGK	TPS62001DGS4	UCC38C45DGKRG4
INA207AIDGSTG4	OPA2703EA/2K5	TLC5615IDGKG4	TPS62002DGS	UCC39002DGK
INA208AIDGSR	OPA2703EA/2K5G4	TLV2541CDGK	TPS62002DGS4	UCC39002DGKG4

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

INA208AIDGSRG4	OPA2704EA/250	TLV2541CDGKG4	TPS62002DGSR	UCC39002DGKR
INA208AIDGST	OPA2704EA/250G4	TLV2541CDGKR	TPS62002DGSRG4	UCC39002DGKRG4
INA208AIDGSTG4	OPA2705EA/250	TLV2541CDGKRG4	TPS62003DGS	VCA820IDGSR
INA226AIDGSR	OPA2705EA/250G4	TLV2541IDGK	TPS62003DGSG4	VCA820IDGSRG4
INA226AIDGST	OPA2725AIDGKR	TLV2541IDGKG4	TPS62003DGSR	VCA820IDGST
INA322EA/250	OPA2725AIDGKRG4	TLV2541IDGKR	TPS62003DGSRG4	VCA820IDGSTG4
INA322EA/250G4	OPA2725AIDGKT	TLV2541IDGKRG4	TPS62004DGS	VCA821IDGSR
INA322EA/2K5	OPA2725AIDGKTG4	TLV2542CDGK	TPS62004DGSG4	VCA821IDGSRG4
INA322EA/2K5G4	OPA2734AIDGSR	TLV2542CDGKG4	TPS62004DGSR	VCA821IDGST
INA326EA/250	OPA2734AIDGSRG4	TLV2542CDGKR	TPS62004DGSRG4	VCA821IDGSTG4
INA326EA/250G4	OPA2734AIDGST	TLV2542CDGKRG4	TPS62005DGS	VCA822IDGSR
INA326EA/2K5	OPA2734AIDGSTG4	TLV2542IDGK	TPS62005DGSG4	VCA822IDGSRG4
INA326EA/2K5G4	OPA2735AIDGKR	TLV2542IDGKG4	TPS62005DGSR	VCA822IDGST
INA327EA/250	OPA2735AIDGKRG4	TLV2542IDGKR	TPS62005DGSRG4	VCA822IDGSTG4
INA327EA/250G4	OPA2735AIDGKT	TLV2542IDGKRG4	TPS62006DGS	VCA824IDGSR
INA327EA/2K5	OPA2735AIDGKTG4	TLV2545CDGK	TPS62006DGSG4	VCA824IDGSRG4
INA327EA/2K5G4	OPA2743EA/250	TLV2545CDGKG4	TPS62006DGSR	VCA824IDGST
INA330AIDGSR	OPA2743EA/250G4	TLV2545IDGK	TPS62006DGSRG4	VCA824IDGSTG4
INA330AIDGSRG4	OPA2743EA/2K5	TLV2545IDGKG4	TPS62008DGS	

対象製品名 - 1.3mil Cu □: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
OPA2354AIDGKR	OPA875IDGKT	REG711EA-2.5/250	TPA2005D1DGNR	TPS60240DGKT
OPA2354AIDGKRG4	OPA875IDGKTG4	REG711EA-2.5/250G4	TPA2005D1DGNRG4	TPS60240DGKTG4
OPA2354AIDGKT	REG113EA-2.5/250	REG711EA-2.5/2K5	TPS2000CDGK	TPS60241DGKR
OPA2354AIDGKTG4	REG113EA-2.5/250G4	REG711EA-2.5/2K5G4	TPS2000CDGKR	TPS60241DGKRG4
OPA2356AIDGKR	REG113EA-2.5/2K5	REG711EA-3.3/250	TPS2000CDGN	TPS60241DGKT
OPA2356AIDGKRG4	REG113EA-2.5/2K5G4	REG711EA-3.3/250G4	TPS2000CDGNR	TPS60241DGKTG4
OPA2356AIDGKT	REG113EA-3.3/250	REG711EA-3/250	TPS2001CDGK	TPS60242DGKT
OPA2356AIDGKTG4	REG113EA-3.3/2K5	REG711EA-3/250G4	TPS2001CDGKR	TPS60242DGKTG4
OPA2357AIDGSR	REG113EA-3/250	REG711EA-3/2K5	TPS2001CDGN	TPS60243DGKR
OPA2357AIDGSRG4	REG113EA-3/250G4	REG711EA-3/2K5G4	TPS2001CDGNR	TPS60243DGKRG4
OPA2357AIDGST	REG113EA-3/2K5	REG711EA-5/250	TPS2065CDGN	TPS60243DGKT
OPA2357AIDGSTG4	REG113EA-3/2K5G4	REG711EA-5/250G4	TPS2065CDGNR	TPS60243DGKTG4
OPA2726AIDGST	REG113EA-5/250	REG711EA-5/2K5	TPS2069CDGN	
OPA2726AIDGSTG4	REG113EA-5/250G4	REG711EA-5/2K5G4	TPS2069CDGNR	
OPA875IDGKR	REG113EA-5/2K5	TPA2005D1DGN	TPS60240DGKR	
OPA875IDGKRG4	REG113EA-5/2K5G4	TPA2005D1DGNRG4	TPS60240DGKRG4	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	ADS1244IDGSR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DGS/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	Per datasheet spec	10	10	10
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Destructive Physical Analysis	Note (1)	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				
(1) Post-MSL: W/B (1st & 2nd), Pad Damage, Mold die adhesion, saw damage				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LM393ADGKR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DGK/8	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	PGA308AIDGSR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DGS/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
High Temp Operating Life	125C, 48, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	Per datasheet spec	77	77	77
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
CSAM	Post HTOL, 1000hr	5	-	-
Destructive Physical Analysis	Note (1)	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				
(1) Post-MSL: W/B (1st & 2nd), Pad Damage, Mold die adhesion, saw damage				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	THS4521IDGKR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DGK/8	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	Per datasheet spec	10	10	10
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Destructive Physical Analysis	Note (1)	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				
(1) Post-MSL: W/B (1st & 2nd), Pad Damage, Mold die adhesion, saw damage				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS40211DGQR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	VSSOP/DGQ/10	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	Per datasheet spec	10	10	10
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
CSAM	Post HTOL, 1000hr	5	-	-
Destructive Physical Analysis	Note (1)	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Thermal Path Integrity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				
(1) Post-MSL: W/B (1st & 2nd), Pad Damage, Mold die adhesion, saw damage				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 7 月	終了	2012 年 12 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2001CDGNR	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	MSOP/DGN/8	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000515	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	NiPdAuAg, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Characterization	Per datasheet spec	10	10	10
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Destructive Physical Analysis	Note (1)	per spec	per spec	per spec
Manufacturability	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
X-ray	top side only	5	5	5
Thermal Path Integrity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				
(1) Post-MSL: Die-attach, W/B (1st & 2nd), Mold die adhesion				